■ 2026 年度 ＣＡＳＥ対応技術動向講演会

次世代自動車センター浜松では、毎年、最新の技術動向をテーマとした「技術動向講演会」を開催しています。

現在、自動車の電動化や自動運転を軸とした車の知能化の技術は、中国が世界をリードしていると言われており、今後、自動車産業の構造変化に大きな影響が出ることが予想されます。

今回、中小企業の皆様が次世代自動車へ取り組む際のヒントとしていただくため、中国の状況等詳しい自動車アナリストの中西孝樹様や株式会社デンソー様から講師をお迎えし、最新情報について解説していただく「CASE 対応技術動向講演会」を開催しました。

また、講演会終了後、講師の方々と参加企業の皆様の意見交換の場として、技術交流会を開催しました。

■日　時 ： ２０２６年１０月２３日（金）（講演会）13 時 30 分～16 時 30 分
（技術交流会）16 時 45 分～18 時 30 分
■会　場 ： 浜松マリオットホテル
■参加者 ：（講演会）７５社／１０８名　（技術交流会）１８社／２８名

【講演会】

次　第	内　　容
主催者挨拶	次世代自動車センター浜松 センター長　堀 算伸
来賓挨拶	浜松市産業部 部長　中村 卓也　様
講演	㈱ナカニシ自動車産業リサーチ 代表アナリスト　中西 孝樹　様 演題：「ＡＩ革命と中国ＡＩＤＶ/ＳＤＶの台頭 －国内自動車産業の勝ち筋－」
	㈱デンソー研究開発センター シニアアドバイザー 兼 ㈱ミライズテクノロジーズ 代表取締役社長　松ケ谷 和沖　様 演題：「自動車技術の進化－ＥＶ、ＡＤ/ＡＤＡＳ、ＳＤＶとそれを支える要素技術－」

＜開会＞





＜主催者挨拶＞

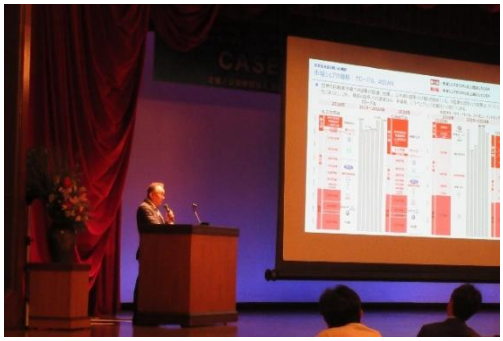


＜来賓挨拶＞



＜講演①：㈱ナカニシ自動車産業リサーチ　中西　孝樹　様＞





（質疑応答）





＜講演②：㈱デンソー　松ケ谷　和沖　様＞






（質疑応答）




【技術交流会】

＜主催者挨拶＞






【参加者の声】

○講演①
・中国メーカーの市場シェアの拡大状況に驚いた。トヨタを筆頭に日本のメーカーがどの様なビジョンをもって動いているか学びになった。
・SDV に伴うものづくり進化（HW4.0）、2030 年に向けて来たるべき構造変化に今から考え動きださなければならないメッセージを強く受け取った。
・完成車メーカーの今後の取組である「SDV/AIDV」「HW4.0」についての情報が得られた。自動車産業の Tier１と中小企業（Tier2,3）が中国にキャッチアップする強い気持ちをもって、個社の固有技術の見える化、デジタル化を進めていく必要があることがわかった。
・グローバル市場で中国のエコシステムに真っ向からあらがうのは難しく、HW4.0 の導入で巻き返すため、OEM、Tier1,2,3 が一体となって向き合う必要があると理解した。
・自動車のものづくりが中国中心で動いていることが理解できた。この動きの中で、どう行動するのかを考えることが重要とわかった。
・日本が技術的に中国に負けていること、中国の技術ノウハウを利用することを検討されていることが事実としてあることに危機感を覚えるとともに非常にためになる内容だった。
・中国の SDV の台頭、モノづくり 4.0、日本の中国標準の採用、「考え動くことが大切」ということが参考になった。
・SDV、AIDV とは具体的にどんな機能を搭載する車軸であるのかよく理解できた。一方、工業製品として（ハードとして）進化させていくポイントが見えてきた。日本の場合、法規制で SDV、AIDV に関係しているところは、世界から取り残されそうと感じつつ SDV、AIDV に必要なハード製品を創出、採用していくことが重要と認識できた。
・豊富かつ最新のデータをもとに、高い角度でもって自動車産業の将来を展望し、進むべき方向性を示していた。
・日本の自動車産業の危機的状況がより鮮明になった。Tier1 や Tier2 を含め意識改革が必要であることが印象に残った。
○講演②
・EV、AD/ADAS、SDV にとって必要な技術、コンポーネントについて、半導体を中心に説明いただいた。
・半導体という立場から自動車技術の進化についての情報が得られた。
・電動化、自動化の現状を知ることができた。時代の流れをよく読んで、必要な製品をつくっていくことが肝要だと思った。
・EV、AD/ADAS、SDV に関する技術的な開発動向の話は、普段あまり聞けないため、大変勉強になった。とてもわかりやすい説明だった。
・ソフトウェアの比重が大きくなり、品質の検証等、非常に難しくなっているのではないかと感じた。
・半導体の自動車との関り、調達・開発の実情について勉強になった。AD/ADAS の考え方、使い方について深い所の情報が参考になった。
・材料研究の重要さ、ソフトウェアアーキテクチャーの理解が必要なことが理解できた。
・これからの自動車に使用される半導体について、作成の段階から CO_2 削減のための工夫をされている点が大切な視点であると感じた。SDV といえど、注目されがちなソフトの部分だけでなく、ハードの部分も重要であるということに気付くことができた。
・社会環境変化と車載電気/電子システムの将来の姿、走行中給電システムが参考になった。
・CO_2 削減、交通事故ゼロを目指し、半導体の開発が重要なことがわかった。
・SDV における ECU、センサーのかかわりが理解できた。
・改めて自動車に使用されている半導体について理解できた。また、SiC の立ち上げが近々あると聞いて期待したい。
・ソフトウェアの進化に伴い、ハード（部品）への要求も変化する。開発課題につなげたいと思った。